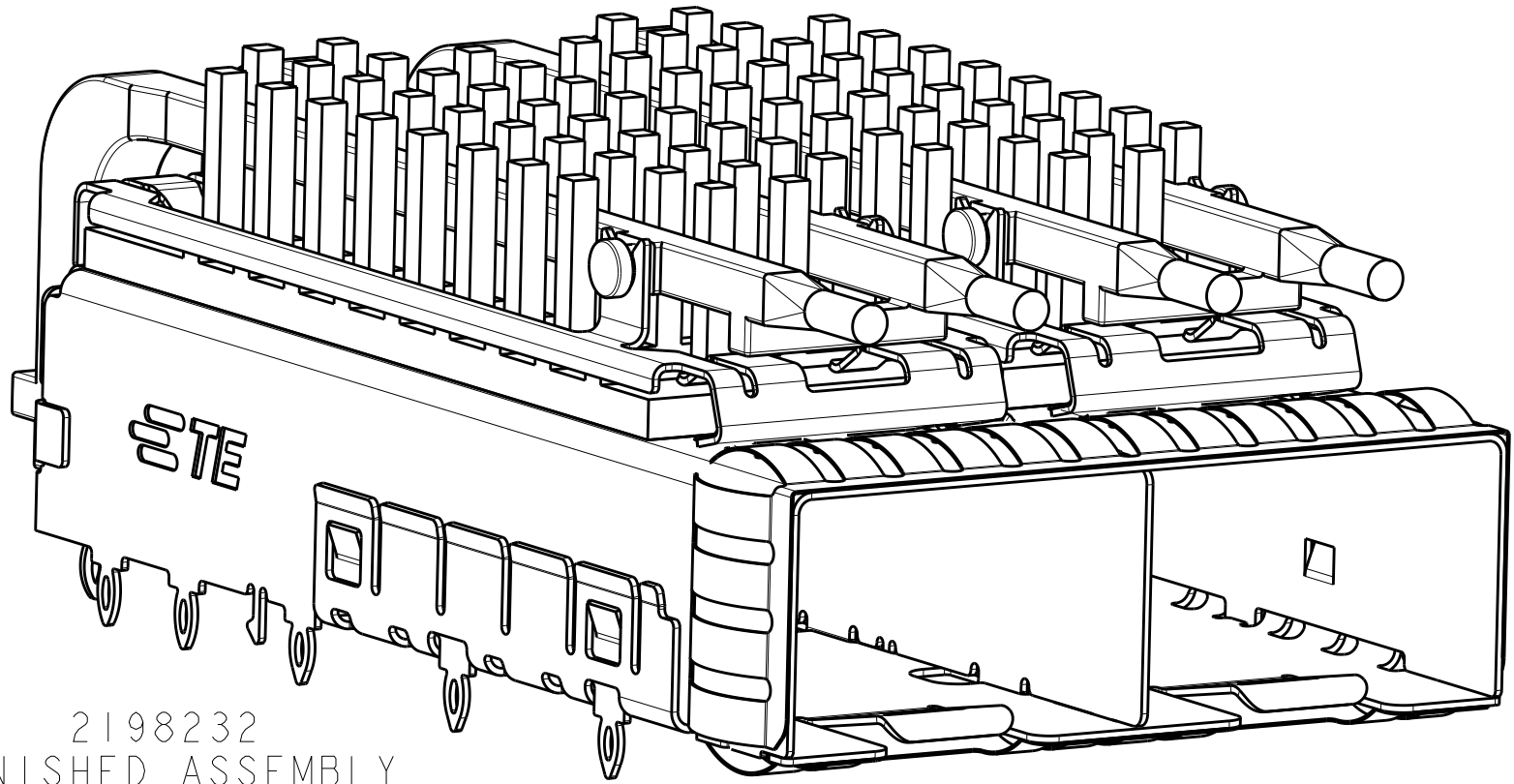


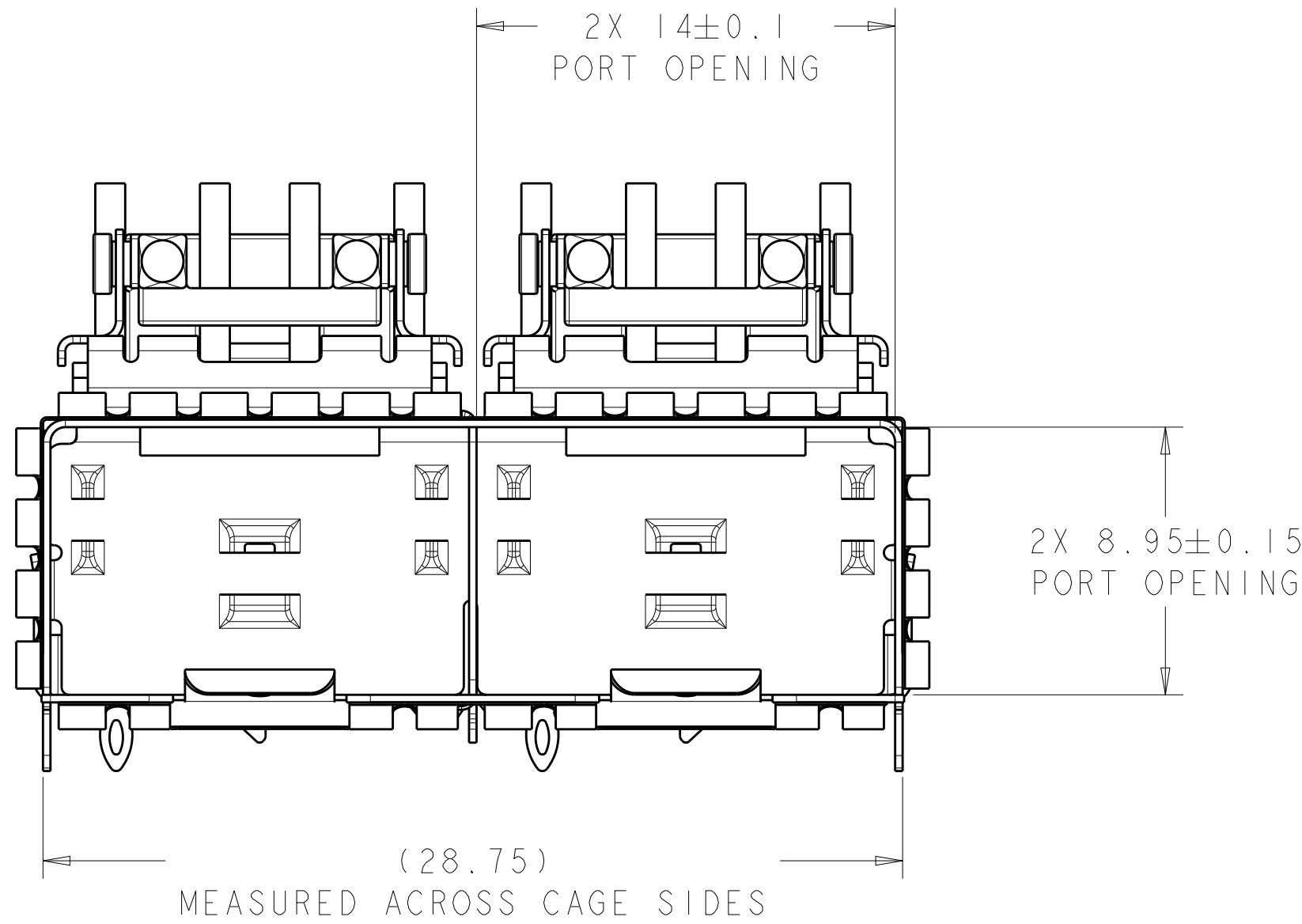
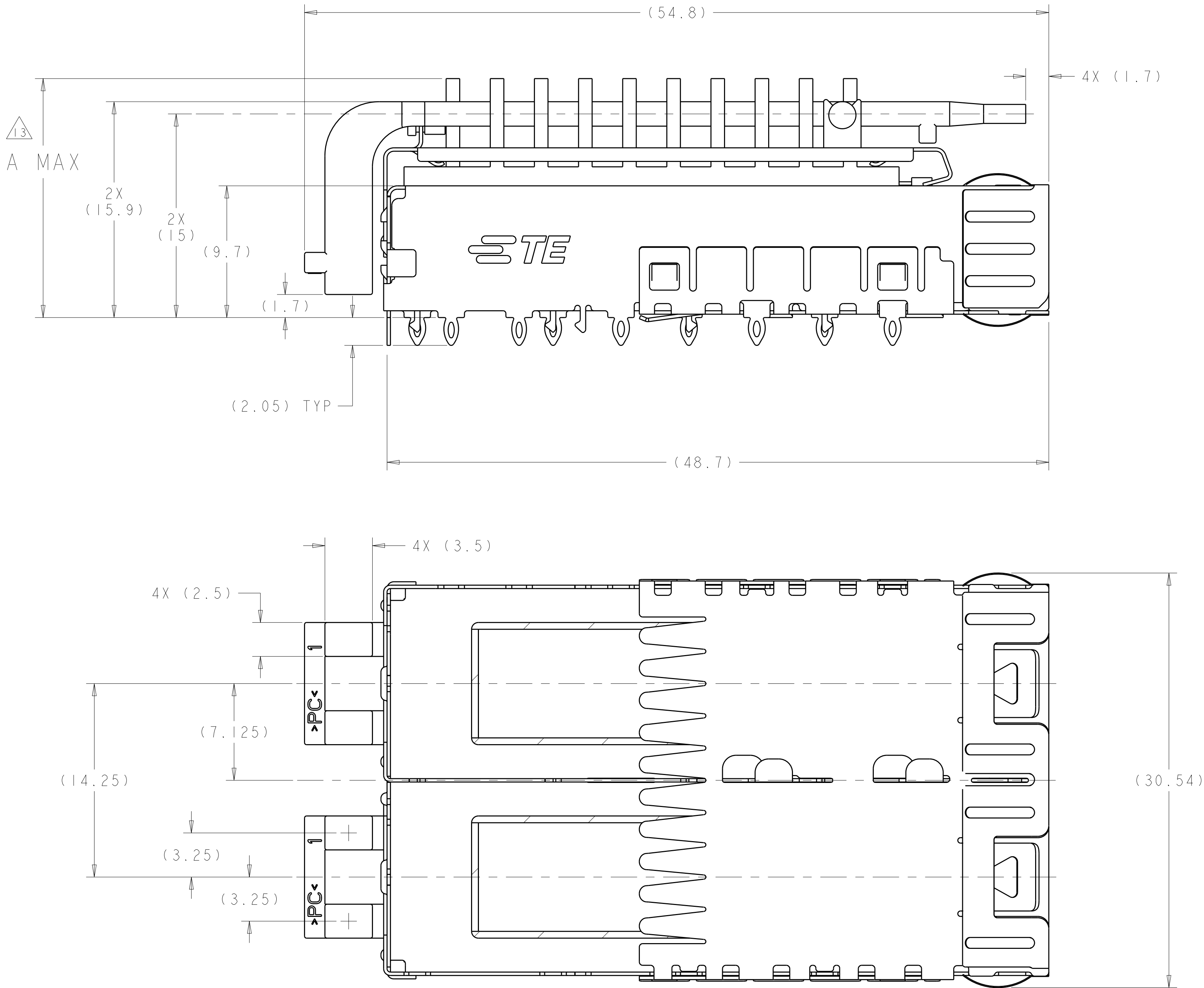


2198232
FINISHED ASSEMBLY
SCALE 4:1

- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
EMI SPRINGS: COPPER ALLOY
HEAT SINK: ALUMINUM
HEAT SINK/LIGHTPIPE CLIP: STAINLESS STEEL.
LIGHTPIPE: POLYCARBONATE, CLEAR
- 2 FINISH:
SPRINGS: MINIMUM OF 0.8um TIN PLATE OVER MINIMUM OF 0.8um NICKEL UNDERPLATE. NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
HEAT SINK: ELECTROLESS NICKEL
HEAT SINK CLIP: PASSIVATE.
- 3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 5 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT RECIEVERS.
6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OR ASME Y14.5M-1994.
- 7 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.5mm
DOUBLE SIDED: 2.25mm
- 8 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT, SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
- 9 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

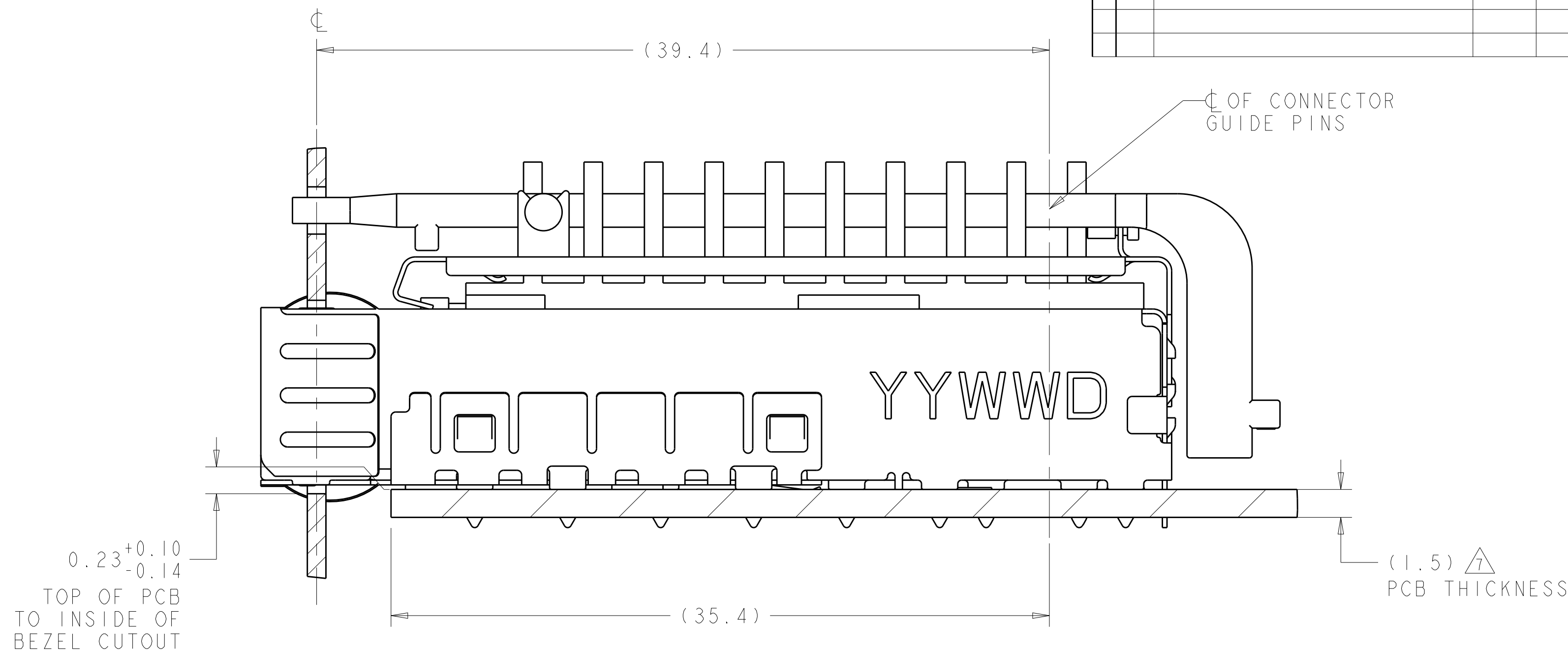
- 10 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
11. CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
- 13 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- 14 HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE TO THE CAGE ASSEMBLY.
- 15 PACKAGED AS A COMPLETE ASSEMBLY.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GP	00		A	RELEASED PER ECO-12-013192	08OCT2012	BMM	MRS
			A1	RELEASED PER ECO-14-008488	06JUNE2014	PP	SH

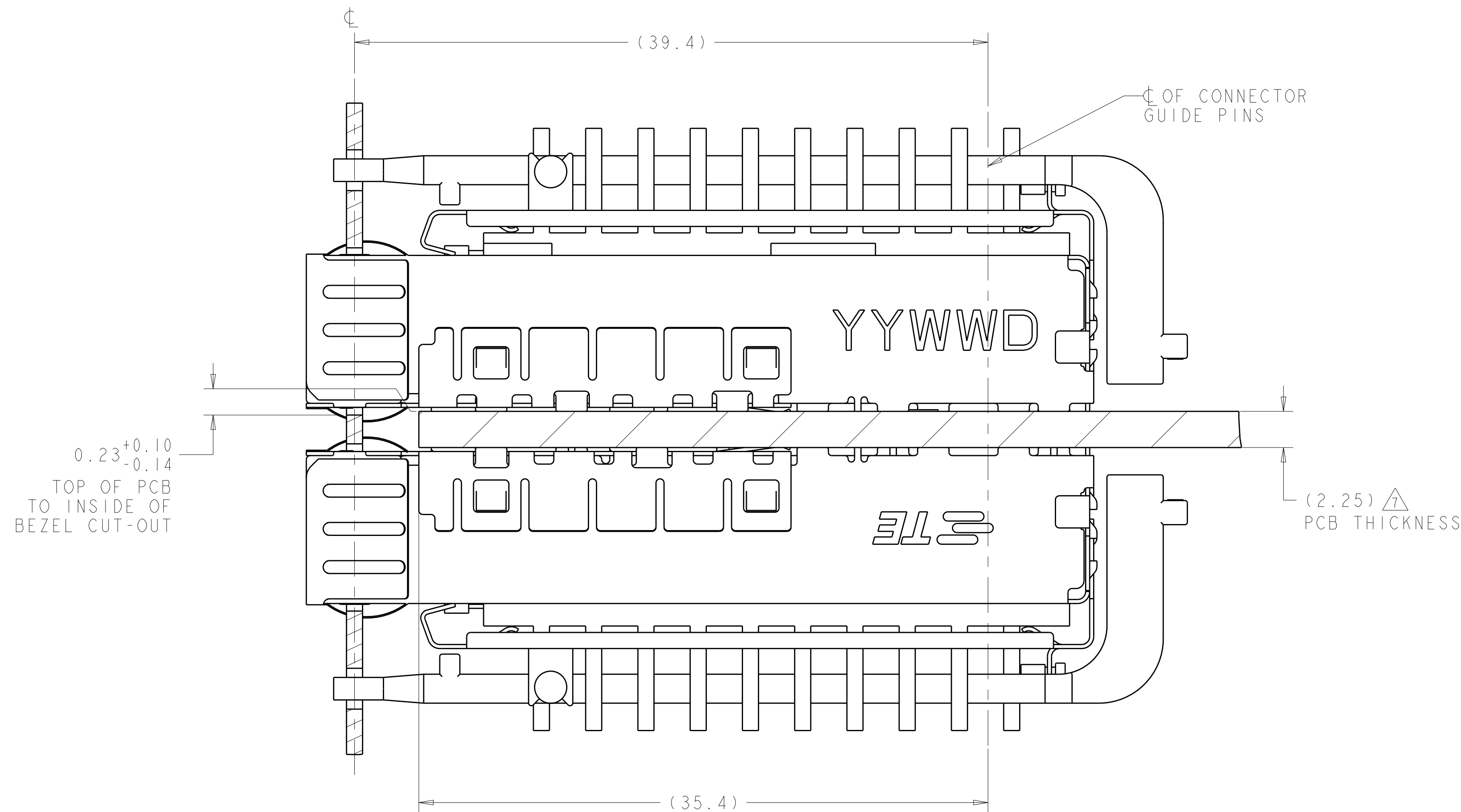


13	22.5	NETWORKING, TALL	2198232-4
13	18.1	NETWORKING, SHORT	2198232-3
14	15.5	SAN	2198232-2
14	13.2	PCI	2198232-1
A MAX		DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MATTHEWS 01NOV2011	TE Connectivity	
		CHK M. SCHMITT 01NOV2011		
DIMENSIONS:		APVD W. SCHMITT 01NOV2011	NAME SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE	
mm		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
		108-2364	RESTRICTED TO	
		APPLICATION SPEC	A100779C=2198232	
		114-13120	SCALE 5:1 SHEET 1 OF 4 REV A1	
MATERIAL		WEIGHT	Customer Drawing	

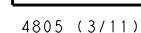


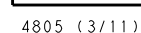
2198232
MOUNTED ON PC BOARD
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL



2198232
MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

4805 (3/11)





Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9